

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2019-016

## 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

### 关于公司涉及诉讼的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：法院已受理尚未开庭
- 上市公司所处的当事人地位：原告
- 涉案的金额：亚翔集成涉及诉讼金额约为人民币127,117,873.09元（不含利息、违约金等），目前尚有部分利息、违约金无法预计。
- 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于该案件尚未开庭审理，诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响暂无法预计。

#### 一、诉讼案件基本情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司与杭州中芯晶圆半导体股份有限公司建设工程施工合同纠纷

##### 1、案件当事人

原告方：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

被告方：杭州中芯晶圆半导体股份有限公司

##### 2、原告方诉讼请求、案件基本情况

诉讼请求：

(1) 判令原告与被告签订的《半导体大硅片（200mm、300mm）项目洁净包合同》解除；

(2) 判令被告支付工程款人民币 127,117,873.09 元；

(3) 判令被告赔偿原告损失人民币 1,271,845.30 元；

(4) 判令被告支付逾期付款之利息（以 127,117,873.09 元为本金，自 2019 年 6 月 6 日起按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至实际支付之日）；

(5) 判令原告在上述 2、3、4 项诉讼请求的总金额范围内对被告名下“半导体大硅片（200mm、300mm）项目”洁净包工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权；

(6) 本案所有诉讼费用由被告承担。

### 3、事实与理由：

原告与被告于 2018 年 12 月 18 日签订《半导体大硅片（200mm、300mm）项目洁净包合同》，约定由被告向原告发包杭州中芯晶圆半导体股份有限公司半导体大硅片（200mm、300mm）项目洁净包工程，工程固定总造价为 230,000,000.00 元，工程地点为杭州市萧山区大江东产业聚集区，双方约定付款方式为：工程预付款为 30%，在合同签订后原告向被告提供相应增值税发票后 30 个工作日内支付；Fab2 满足各项洁净指标并空态测试合格后支付 20%；Fab1 满足各项洁净指标并满足设备搬入条件后支付 20%；Fab1 满足各项洁净指标要求并空态测试合格后支付 20%；验收合格后支付 7%；剩余 3%作为质保金，质保期为两年。

上述合同签订后原告积极组织人员施工，投入大量物力财力，工程质量多次获得被告赞扬。然而在施工过程中，被告未及时向原告移交施工场地，

致使部分施工现场原告不能及时进入作业。此后，被告以工程存在质量问题及工期逾期为由发函通知要求解除上述工程合同，并于2019年5月17日起动用数百号社会人员阻止原告进入施工场所，导致原告400余名工人及工程师至今无法进入现场施工，工人及施工机台滞留现场数日，同时在未经原告允许的前提下强行接管工程。原告于2019年5月20日回函被告，告知其解除工程合同无事实及法律依据，要求其继续履行合同，但被告仍置之不理。被告阻止原告进入现场施工已构成严重违约，并导致双方签订的工程合同无法继续履行。

上述已施工工程经原告结算，造价为人民币237,117,873.09元，原告因被告的违约行为而造成各项损失合计人民币1,271,845.30元。截止起诉之日，被告仅支付原告工程款人民币110,000,000.00元，剩余工程款127,117,873.09元及损失未付给原告。

## 二、案件进展情况

2019年6月11日亚翔集成收到浙江省杭州市中级人民法院的受理通知书（2019）浙01民初2127号，目前案件已被法院受理尚未开庭。

## 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

鉴于案件尚处于法院已受理尚未开庭阶段，暂无法预计诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。

目前，公司经营情况正常。公司会持续关注相关案件进展情况，依照法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2019年6月13日